

ブロードコム (AVGO)

【セクター】 半導体

信買

【市場】 NASDAQ

信売

【企業概要】

米半導体大手。無線・ブロードバンド通信向けの半導体やソフトウェアを製造販売しています。幅広い IP (知的財産権) ポートフォリオを有しており、無線通信向け半導体が強みです。アップルなど大手ハイテク企業に半導体を供給しています。部門別売上構成比（2023年10月期）は半導体ソリューションが78.7%、インフラストラクチャー・ソフトウェアが21.3%です。地域別売上構成比（同）は中国が32.2%、米国が19.5%、シンガポールが12.5%で、それ以外が35.8%です。

【業績】（単位：売上高、純利益は百万ドル、EPS、1株配当、BPSはドル、ROE、自己資本比率は%、純利益、EPSは調整後ベース）

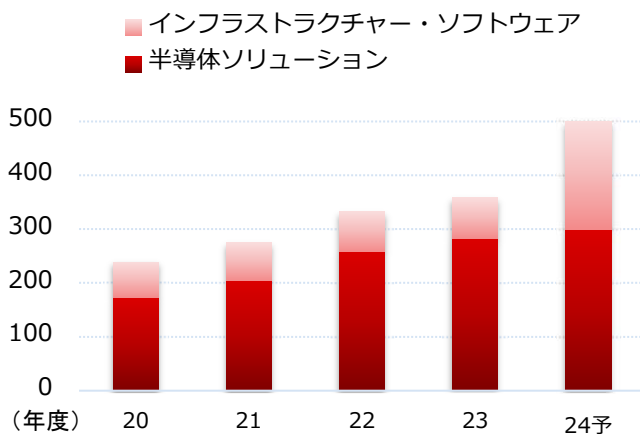
決算期	売上高	純利益	EPS	1株配当	BPS	ROE	自己資本比率
22.10期	33,203	16,526	37.64	16.40	54.3	51.1	31.0
23.10期	35,819	18,378	42.25	18.40	57.9	60.3	32.9
24.10期（予）	50,125	22,659	46.88	20.91	78.5	71.5	-

※EPS：1株当たり利益、BPS：1株当たり純資産、ROE：株主資本利益率

（出所）BloombergのデータよりSBI証券作成

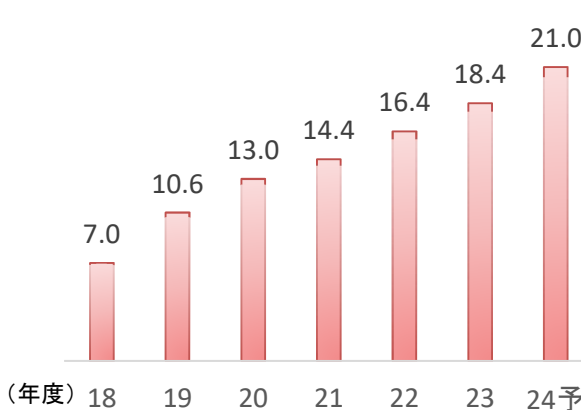
【主要指標】

部門別売上高の推移（通期ベース、億ドル）



（出所）BloombergデータよりSBI証券作成

1株当たり配当推移（ドル）



（出所）BloombergデータよりSBI証券作成

【会社の見方】

通信用半導体大手として、アップルを筆頭とするスマートフォンメーカーやハイパースケールデータセンター、ネットワーク機器メーカーなどが主要顧客です。ソフトウェア事業も強化しており、この分野ではM&Aを活用しています。2023年11月に仮想化・クラウド技術大手の米VMウェアの買収を完了しました。業績は順調に拡大しており、23.10期は売上高が350億ドルを超え、過去最高を記録しました。今後は生成AI関連製品による業績への貢献も期待できそうです。半導体の売上高に占める生成AI関連製品の比率は2023年10月期に15%でしたが、2024年10月期は35%に拡大すると見込んでいます。2011年度以降、増配傾向が続いています。

【見通し・注目点】

11-1月期は、売上が前年同期比4%増（半導体が同3%増、インフラストラクチャー・ソフトウェアが同7%増）、調整後EPSが同6%増で、いずれも市場予想を上回りました。半導体は各種産業向けの弱さを人工知能（AI）関連の伸びでカバーしています。2024年10月のガイダンスは、売上が買収効果により前年比40%増の500億ドル、調整後EBITDA（利払い、税金、償却前利益）率は約60%としました。調整後EBITDAは300億ドル相当で前年実績に対して29%増の計算です。

本レポートに関するご注意事項

- ・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。
- ・本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。本資料の内容は作成時点のものであり、信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したのですが、正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に記載の情報、意見等は予告なく変更される可能性があります。

手数料及びリスク情報等

- ・SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。